

晶片短缺阻礙全球經濟復甦

資料蒐集：西班牙/駐西班牙台北經濟文化辦事處經濟組

西班牙 ABC 日報 2021 年 5 月 23 日報導，由於全球受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，遠距辦公及居家防疫興起，使許多企業與民眾在購買辦公及娛樂電子產品需求大增，惟晶片製造遠落後於市場需求，智慧型手機、電腦、汽車、飛機、醫療設備及家電等產品供應不足，造成數十億美元之損失，並阻礙全球經濟復甦。

波士頓顧問公司(Boston Consulting Group, BCG)之半導體專家 Antonio Varas 表示，半導體產業之製造不易依據市場需求而變動，改變其生產線製程需耗時 3 個月，而建造工廠則需 2 至 4 年，且須投入巨額資本額。設立一間新半導體廠之成本係依該工廠所需技術先進程度而有差別，僅建造工廠而未含其維修之成本已高達 50 億至 200 億美元。半導體產業難以增加新供應商，係高進入門檻之產業。V 專家表示，在新冠肺炎疫情之前，BCG 預測 2020 年晶片需求將成長 7%，而疫情後儘管工業及汽車銷售量下降，惟市場其他商品之需求大幅增加，使晶片需求呈 2 位數成長。

晶片供需不平衡已對全球通貨膨脹造成威脅，且晶片製造能否於短期內供應全球所需亦為重大問題。各界對於晶片短缺將持續時間長短看法不一，美國英特爾(Intel)最悲觀，認為達到晶片供需均衡至少需耗時 2 年，荷蘭商安智銀行(ING)中國分行主管及經濟學家彭藹嬌認為，臺灣係晶片生產之關鍵重地，惟目前正面臨缺水、缺電及疫情可能導致封城、港口工人數減少及影響晶片出口等問題，恐使晶片短缺更加嚴重。

由於半導體產業之供應鏈十分複雜，包括設計、製造、組裝、封裝及測試等均有其困難度，且產線主要位於中國、臺灣、南韓、日本、美國及歐洲等國家，恐不易解決晶片短缺問題。BCG 報告認為未來 10 年全球晶片之產能有 24%將集中於中國，臺灣將提供全球 21%產能、南韓為 19%、日本為 13%、美國為 10%，而歐洲各國則為 8%。中國政府日前訂定 2025 年晶片自給率達 70%之目標，並將投入約 1,500 億美元資金於半導體產業，美國政府亦釋出 500 億美元支持半導體產業，並鼓勵半導體業者於美國投資，如邀請台積電於亞利桑那州(Arizona)設置半導體工廠，投資金額約 120 億美元。日本亦邀請台積電至日本設廠，以提供當地汽車、風力發電及工業機械等產業之晶片需求。

歐盟執委會(Comisión Europa)報告指出，歐洲仍依賴美國之晶片設計及亞洲之生產。儘管歐盟國內生產毛額(GDP)占全球之 23%，惟晶片收入則僅占 9%。歐盟內部市場委員 Thierry Breton 則強調，歐盟將提出半導體聯盟及其願景，目前已獲 22 個成員國支持，目標於 2030 年提升歐盟晶片全球產能自目前之 9%提升至 20%。